

LASER X



高精度自动贴片机

产品特性

- 放置精度 $\pm 5\mu\text{m}$ (3σ)
- 能够处理微小芯片
- 参数序列控制可以对压力进行编程控制
- 压力反馈方法实现了高精度的压力控制
- 4* 6英寸晶圆环

性能参数

	参数	规格
芯片	适用的产品类型	VCSEL / LD / PD / TIA / Driver / COC / TEC
	芯片尺寸最小	0.15mm
	芯片尺寸最大	8mm
	芯片厚度	0.2mm
	晶圆尺寸	6 inch
材料	材料长度PCB	$\leq 220\text{mm}$
	材料宽度	$\leq 100\text{mm}$
	材料厚度	0.7~3mm
速度	生产周期时间 (1个芯片)	5s
	UPH	> 700
精准度	贴片压力	15g~200g +/-10%
	放置准确度	$\leq \pm 5\mu\text{m}@3\sigma$ (芯片 $<1\text{mm}$)
	芯片角度	$\leq 0.3\text{deg}@3\sigma$
相机	相机传感器分辨率	3072x2048
	相机视野	1.8x1.2(4x lens)
电气规格	电源	220VAC/50Hz 4KVA
	空气	5 ~ 6Kgf/cm ²
设备尺寸与重量	尺寸	1520x1400x1800 (mm)
	重量	2200kg